



IEEE MTT-S Simposio Internacional de Microondas *Microondas en mi Mente*



IEEE

Del 15 al 20 de junio, 2008
Atlanta, Georgia
www.ims2008.org



Solicitud de Escritos Técnicos

El Simposio Internacional de Microondas de IEEE MTT-S 2008 se celebrará en Atlanta, Georgia, del Domingo 15 al Viernes 20 de Junio de 2008, como el evento central de la semana de las Microondas del 2008. Se solicitan escritos técnicos que describan trabajos originales en investigación, desarrollo y aplicación de las diversas teorías de RF y Microondas.

Semana de las Microondas, 2008: Las sesiones técnicas del IMS 2008 se llevarán a cabo desde el día Martes al día Jueves de la Semana de las Microondas. Las clínicas técnicas se realizarán los días Domingo, Lunes y Viernes. Adicional al IMS 2008 y durante la semana de las Microondas, también se llevarán a cabo en Atlanta una exposición técnica, una exhibición histórica, el Simposio RFIC (www.rfic2008.org), y la Conferencia ARFTG (www.arftg.org).

Envío de documentos técnicos en formato electrónico: Los escritos técnicos para este simposio deberán ser enviados por medio del sitio del IMS 2008 www.ims2008.org. La información completa sobre el envío los documentos técnicos, inscripción para conferencias, y otras informaciones de importancia, también pueden encontrarse en el sitio web del IMS 2008.

Propuestas Invitadas: Invitamos propuestas de Clínicas Técnicas (de nivel de tutoría a experto), de Sesiones Especiales (especializadas y honoríficas), y de Paneles de Discusión. Para sugerencia de temas, o para ayuda voluntaria en la organización de clínicas técnicas, sesiones especiales o paneles de discusión, por favor contacte al miembro respectivo del comité organizador, listado en esta página.

La Ciudad de Atlanta, ofrece muchas actividades divertidas y emocionantes que puede disfrutar tanto usted como su familia su familia. Puede visitar el acuario más grande del mundo, con ocho millones de galones de agua dulce y de mar, y más de 100 000 animales de todas partes del mundo. Aprecie el conjunto más grande de artículos de colección de Coca-Cola, únase a la cacería de su "fórmula secreta" y descubra el "Nuevo Mundo" Coca-Cola. Visite el Parque del Centenario Olímpico en su camino al estudio de noticias Internacionales de CNN. Entérese de la última acción en el baseball de la MLB, asistiendo a un juego de los Bravos de Atlanta en el Turner Field o experimente el espectáculo laser más grande del mundo en el paquete Stone Mountain. Todas estas aventuras y muchas más le esperan en el IMS 2008. Para mayor información visite www.atlanta.net.

Fechas límites para el envío de documentos técnicos.

Propuestas de cursos cortos, clínicas técnicas,

paneles de discusión y sesiones especiales:

14 de Septiembre de 2007

Manuscritos para revisión:

7 de Diciembre de 2007

Manuscritos en su versión final:

7 de Marzo de 2008

Todos los documentos deben ser enviados a través del portal de www.ims2008.org

TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBEN ENVIARSE EN FORMATO PDF.

No se aceptarán copias impresas. Los autores serán responsable del formato de los documentos. Los tipos de letras fuente utilizados deben ser compatibles con IEEE Xplore.

Miembros adicionales del Comité Organizador: Farrokh Ayazi, Bhaskar Banerjee, Keefe Bohannon, Cathy Beam, DeeDee Bennett, Daphne Bronner, Yi-Jane E. Chen, Charlie Coulter, John Cressler, Debasis Dawn, Mononita Ghosal, Gordon Harrison, Deuk Hyoun Heo, Vince Hietala, Per O. Iversen, Jeff Kemp, Kevin Kornegay, Devi Laskar, Kirk Laursen, Daniel Leatherwood, Jonghoon Lee, Debra Lynch, Mark Mitchell, Frank Neston, Barry Perlman, Andy Peterson, George Ponchak, Luis Resta, Pete Rodrigue, Luca Roselli, Charlie Rucker, Amanda Scacchitti, Chris Scholz, Shyh-Chiang Shen, Jim Stratigos, Dane Thompson, Anya Traille, Ryan Tyson, Jack Vickers, Jeff Waggoner, Brent Wagner, and Jim Wiltse.

Presidente

Joy Laskar
Georgia Tech
joy.laskar@ece.gatech.edu

Vicepresidente

Mike Harris
GTRI
hmharris@ieee.org

Programa Técnico

Manos Tentzeris (Presidente)
Georgia Tech
etentze@ece.gatech.edu

Stephane Pinel (Vicepresidente)

GEDC
pinel@ieee.org

Kyutae Lim (Vicepresidente)

GEDC
ktlim@ieee.org

John Papapolymerou (Vicepresidente)

Georgia Tech
papapol@ece.gatech.edu

Clínicas Técnicas (Workshops)

Edward Gebara
Quellan
edward@quellan.com

Foro Interactivo

Daniela Staiculescu
Georgia Tech
dstaiculescu@ieee.org

Sesiones de Panel de Discusión

Chang-Ho Lee
Samsung
changholee@samsung.com

Sesiones Especiales

Gerald DeJean
Microsoft
dejean@microsoft.com

Sesiones Plenarias

Sanjay Raman
Virginia Tech
sraman@vt.edu

Administración de escritos electrónicos.

John Cressler
Georgia Tech
cressler@ece.gatech.edu

Publicaciones

Samir El-Ghazaly
University of Tennessee
elghazaly@utk.edu

Operaciones

Chris Evans
GEDC
chris.evans@gedcenter.org

Finanzas

Herb Lehman
GEDC
herb.lehman@gedcenter.org

Arreglos Locales

Steve Kenney
Georgia Tech
j.s.kenney@ieee.org

Administración de Conferencias

Elsie Cabrera
IEEE Conference Mgmt Services
e.cabrera@ieee.org

Administración de Exhibiciones

Harlan Howe
Microwave Journal
hhowe@mwjournal.com

Envío de Documentos Técnicos

Para enviar un documento técnico, debe comenzar descargando el documento molde (Template) de www.ims2008.org. Los autores deberán ceñirse al formato provisto en este documento molde. Los documentos técnicos deben enviarse en formato PDF y su tamaño deberá ser inferior a 1 MB.

Los documentos deben ser enviados a www.ims2008.org a más tardar el 7 de Diciembre de 2007. Envíos tardíos no serán considerados. El sistema sólo aceptará cuatro páginas, incluyendo texto e imágenes.

Se requerirá que los autores de los documentos técnicos aceptados envíen un documento final para publicación en el Disco Compacto del Simposio. La notificación de aceptación en el simposio y la información necesaria para el envío de la versión final será enviada en enero de 2008.

Criterio de Selección de Documentos Técnicos: Todos los documentos enviados deberán estar redactados en inglés. Los subcomités del IMS 2008 revisarán dichos documentos. Los criterios de selección incluyen:

- *Originalidad:* ¿De qué manera es la contribución única, significativa y de vanguardia?
- *Contenido Cuantitativo:* ¿Brinda el documento una descripción explícita del trabajo con información cuantificada lo apoya?
- *Claridad:* ¿Es la contribución clara? ¿Son la escritura y las imágenes anexadas claras y fáciles de entender? ¿Fueron incluidas referencias a trabajos previos de los autores y de otros sobre el tema?
- *Interés de la membresía del MTT-S:* ¿Por qué el trabajo debe ser presentado en esta conferencia?

Permisos: Es responsabilidad del autor obtener los permisos necesarios de la Compañía o del Gobierno para la publicación de su trabajo, de forma previa al envío del documento técnico. El documento técnico aceptado y en su versión final, deberá estar acompañado de una declaración firmada por el autor en la que se establezca que dichos permisos han sido concedidos, así como también deberá adjuntarse un formulario completado de Derechos de Autor de IEEE. Los detalles de estos permisos están disponibles en www.ims2008.org.

Áreas Técnicas: Las áreas técnicas seleccionadas por el autor (véase la siguiente página) serán utilizadas para la elección del comité que revisará el documento. El autor deberá escoger un área principal y otra secundaria al completar el formulario del registro. El extracto del documento deberá contener información que refleje en forma clara el área técnica elegida. El Comité de Documentos Técnicos del IMS 2008 podrá transferir documentos clasificados en forma inapropiada, a los subcomités correspondientes.

Formatos de las Presentaciones: El Simposio Internacional de Microondas (IMS) ofrece tres formatos de presentaciones:

- **Documentos de Tamaño Completo:** reportarán contribuciones significativas, avances o aplicaciones de tecnologías en el área de las microondas en un formato de presentación formal con interacción limitada del público.
- **Documentos Técnicos Cortos:** típicamente reportarán mejoras o refinamientos específicos en tecnologías de punta, en un formato de presentación formal con interacción limitada del público.
- **Documentos Técnicos con foro interactivo.** proveerán una oportunidad a los autores para presentar resultados teóricos o experimentales con mucho mayor detalle en un formato afiche, y/o presentar hardware, realizar demostraciones, y conducir discusiones informales junto con colegas interesados en el tema.

Las preferencias de los autores serán respetadas en la medida de lo posible, no obstante, el documento técnico será ubicado en la sección más apropiada, con el formato de presentación que sea más consistente con los lineamientos del programa técnico. Todas las presentaciones del IMS 2008, serán realizadas utilizando equipos de proyección digital. No se proveerán proyectores transparencias ni de filminas de 35 mm.

Concurso de Documentos Técnicos para Estudiantes: Como parte de las actividades del simposio, también se llevará a cabo una competencia de documentos técnicos confeccionados por estudiantes. Dichos trabajos serán evaluados en contenido y en presentación. Serán premiados el primer, segundo y tercer lugar. Para ser considerado para premiación, el estudiante debe haber sido de tiempo completo (mínimo de 9 hr/cr post-grado o 12 hr/cr en licenciatura) en el periodo durante el cual el documento fue producido, debe haber sido el autor principal, y deberá presentar su trabajo en el Simposio. Se requerirá que el estudiante provea la dirección de correo electrónico de su profesor supervisor como parte del proceso de aplicación. Se enviará automáticamente un memorándum al profesor supervisor, para certificar que el trabajo fue hecho principalmente por el estudiante.

Notificación: La decisión de aceptación será notificada a los autores en enero de 2008, vía e-mail. La carta de aceptación referirá al autor al sitio web para los formularios y proveerá instrucciones detalladas sobre la preparación de los manuscritos para publicación. Los manuscritos finales deberán enviarse más tardar el 7 de marzo de 2008, para su publicación en el Disco Compacto del simposio, y para calificar para la presentación en el Simposio.

Áreas Técnicas

1. Análisis de Campos y de Ondas Guiadas

Estructuras de guías de onda innovadoras, nuevos fenómenos físicos en líneas de transmisión y guías de ondas, nuevos métodos para la solución de problemas en ondas guiadas.

2. Técnicas en el Dominio de la Frecuencia

Métodos en el dominio de la frecuencia para la solución numérica de problemas de electromagnetismo, incluyendo interacción de campos con dispositivos, con circuitos y con otros procesos físicos.

3. Técnicas en el Dominio del tiempo

Métodos en el dominio del tiempo para el modelado numérico de electrónica de alta frecuencia, incluyendo modelos basados en comportamientos físicos (electromagnéticos, térmicos, mecánicos y de semiconductores).

4. Algoritmos y Técnicas CAD

Métodos de análisis de circuitos, métodos de optimización, análisis estadístico.

5. Modelaje de dispositivos lineales

Modelos lineales de dispositivos activos y pasivos.

6. Modelaje de dispositivos no lineales

Modelos de dispositivos de alta señal (Large-Signal), caracterización, extracción de parámetros, validación.

7. Análisis de circuitos no lineales y simulación de sistemas.

Balaceo armónico (Harmonic Balance), técnicas de simulación, análisis de espurias y distorsión, simulaciones de sistemas y modelaje del comportamiento.

8. Elementos de líneas de transmisión

Líneas de transmisión y guías de ondas planares, no planares y microfabricadas, incluyendo estructuras periódicas y de tipo meta-material, discontinuidades, juntas y transiciones.

9. Elementos de circuitos pasivos

Acopladores, divisores/combinadores, híbridos, resonadores, perspectivas de diseño de circuitos utilizando modelos con elementos discretos (lumped elements).

10. Filtros Pasivos y Multiplexadores planares

Sintetización y análisis innovadores de filtros planares y multiplexadores. Incluye estructuras planares superconductoras.

11. Filtros pasivos y Multiplexadores no planares

Guías de ondas, resonadores dieléctricos y estructuras superconductoras no planares.

12. Filtros activos e integrados.

Filtros integrados (en Si, LTCC, LCP, MCM-D, GaAs, ...), filtros activos, sintonizables y reconfigurables. Filtros basados en metamateriales, DGS, EBG, y otras estructuras.

13. Componentes Ferroeléctricos, de Ferrita y de ondas Acústicas

Dispositivos Ferroeléctricos, de ferrita (de volumen y de capa delgada), dispositivos de ondas acústicas superficiales y volumétricas, incluyendo dispositivos FBAR.

14. Componentes y tecnologías MEM

Componentes y subsistemas RF microelectromecánicos y microfabricados: interruptores, resonadores, filtros pasivos sintonizables, cambiadores de fase, filtros reconfigurables y antenas. Modelado, empaquetamiento, fiabilidad, nuevos materiales y procesos de ensamblaje.

15. Dispositivos semiconductores y tecnologías de Circuitos Monolíticos Integrados.

Componentes integrados multifunción y monolíticos: MMICs en GaAs, SiGe ICs y otras tecnologías en RF, microondas, y ondas milimétricas. Fabricación, fiabilidad, análisis de fallas, efectividad de producción en masa y costo de MMICs.

16. Generación de Señales

Osciladores pulsados y de onda continua, VCOs, DROs, YTOs, PLOs, y sintetizadores de frecuencia. Aplicaciones de nuevos dispositivos y resonadores, ruido en osciladores y técnicas de sintetizado digital directo.

17. Conversión y Control de Frecuencia

Interruptores electrónicos, cambiadores de fase, limitadores, mezcladores, multiplicadores y divisores de frecuencia.

18. Aplicaciones y tecnologías de HF/VHF/UHF

Tecnologías de HF, VHF, y UHF incluyendo componentes activos y pasivos, componentes distribuidos y discretos, transmisores y receptores.

19. Dispositivos amplificadores de potencia y circuitos integrados

Diseño y desempeño de amplificadores de potencia de componentes discretos e integrados para RF, microondas, y ondas milimétricas, dispositivos de banda prohibida ancha.

20. Amplificadores de alta potencia

Diseño y caracterización de amplificadores de alta potencia, así como su caracterización, técnicas de linealización, técnicas de combinación de potencia, electrónica de vacío.

21. Componentes y receptores de bajo ruido.

Amplificadores, detectores, dispositivos, receptores, radiómetros, modelos y métodos de caracterización para circuitos y componentes de bajo ruido.

22. Componentes y tecnologías de ondas milimétricas y en el rango de los Terahertz

Tecnologías, componentes y aplicaciones por superior a los 30 Ghz, dispositivos de ondas submilimétricas/terahertz, instrumentos y aplicaciones incluyendo generación de imágenes mediante ondas THz.

23. Fotónica de microondas.

Interacciones y tecnologías de dispositivos a nivel óptico-microondas. Tecnología Inalámbrica sobre fibra, tecnología óptica de espacio libre, aplicaciones optoelectrónicas de cable de banda ancha, efectos de transmisión óptica.

24. Circuitos digitales y sistemas a velocidades GHz

Componentes, módulos y subsistemas de alta velocidad y de señales mezcladas; ADC, DAC, DDS y Radio definida por Software; Interconexiones y backplanes; integridad de señal y equalización; transmisión e interfaces electroópticas.

25. Empaquetamiento, Interconexiones, MCMs y Fabricaciones híbridas.

Substratos y dieléctricos, empaquetamiento de circuitos y subsistemas, métodos de ensamblaje, integración híbrida, interconexiones, módulos multi-chip, (MCMs), fabricación híbrida, efectividad de producción en masa y costo.

26. Técnicas de Instrumentación y Medición

Mediciones de red, en el dominio del tiempo y de la frecuencia, mapeo de campos, corrección y estimación de errores, mediciones de materiales.

27. Efectos biológicos y aplicaciones médicas

Aplicaciones biomédicas de las microondas, aplicaciones en biología, campos de microondas e interacción con tejidos.

28. Antenas inteligentes, combinación espacial de potencia y arreglos en fase

Antenas inteligentes para aplicaciones inalámbricas, combinación espacial de potencia, arreglos en fase, sistemas retrodirectivos, módulos T/R, exploración de múltiples haces, antenas activas integradas.

29. Radares y sistemas de comunicación de banda ancha.

Sistemas de comunicación de banda ancha y MMW para aplicaciones terrestres, vehiculares, satelitales y en interiores. Sistemas y subsistemas UWB.

30. Sistemas de comunicación Celulares e inalámbricos.

Arquitecturas de sistemas y transceptores para tecnologías celulares 3G/4G, WLAN, UWB, WIMAX, Radio definida por software, y sistemas de radio inteligente (cognitive radio).

31. Sensores y sistemas de sensores

RFID, IVHS, microsensores inalámbricos, pruebas no destructivas, generación de imágenes y sensado remoto.



IEEE MTT-S Simposio Internacional de Microondas *Microondas en mi Mente*



IEEE

Del 15 al 20 de junio, 2008
Atlanta, Georgia
www.ims2008.org



Fechas límites para el envío de documentos técnicos.

Propuestas de cursos cortos, clínicas técnicas,
paneles de discusión y sesiones especiales:

14 de Septiembre de 2007

Manuscritos para revisión:

7 de Diciembre de 2007

Manuscritos en su versión final:

7 de Marzo de 2008

Todos los documentos deben ser enviados a través del portal de www.ims2008.org

TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEBEN ENVIARSE EN FORMATO PDF.

No se aceptarán copias impresas. Los autores serán responsables del formato de los documentos. Los tipos de letras fuente utilizados deben ser compatibles con IEEE Xplore.

Visite el sitio web del IMS 2008 en: www.ims2008.org

IEEE
468 Walden Trail
Waxhaw, NC 28173
USA

Non-Profit
US Postage PAID
Permit No. 1715
Pittsburg, PA

IEEE MTT-S International Microwave Symposium 2008
Solicitud de Escritos Técnicos